06;07

Структура и фотопроводимость эпитаксиальных слоев SiGe/Si, модифицированных моноимпульсным лазерным облучением

© Г.Д. Ивлев, Н.М. Казючиц, С.Л. Прокопьев, М.С. Русецкий, П.И. Гайдук

Белорусский государственный университет, Минск E-mail: ivlev-1947@mail.ru

Поступило в Редакцию 26 июня 2014 г.

Методами электронной микроскопии исследовано воздействие наносекундных импульсов излучения рубинового лазера на структурное состояние и морфологию эпитаксиальных слоев твердого раствора SiO_{0.5}Ge_{0.5} на кремнии с инициированием фазового перехода кристалл—расплав. Получены данные о фотоэлектрических параметрах лазерно-модифицированных слоев, обладающих ячеистой структурой вследствие сегрегации германия на стадии отвердевания бинарного расплава.

Твердые растворы $Si_{1-x}Ge_x$ с задаваемой параметром "х" шириной запрещенной зоны применяются/формируются при создании различных микро- и оптоэлектронных приборных структур, в технологии которых может быть эффективно использована импульсная лазерная обработка (ИЛО) — весьма привлекательный как с практической, так и с научной точек зрения метод модификации полупроводниковых материалов и тонкопленочных систем [1]. Эффекты ИЛО различных германий-кремниевых структур в наносекундном диапазоне длительностей воздействующего излучения исследовались в ряде работ [2–8], в том числе в режимах наносекундной ИЛО [8] указанных гетероэпитаксиальных слоев. Однако в литературе практически отсутствуют сведения об изменении фотоэлектрических параметров таких слоев во взаимосвязи с модификацией их структурного состояния вследствие ИЛО.

В этом контексте цель данной работы заключалась в исследовании структуры и фотопроводимости (ФП) эпитаксиальных слоев Si_{0.5}Ge_{0.5}

9

на кремнии, модифицированных наноимпульсным излучением рубинового лазера, в сравнении с их исходными характеристиками.

Гетероструктуры препарировались методом молекулярно-лучевой эпитаксии (установка VG Semicon V80) на стандартных подложках Si(100) *n*-типа проводимости с удельным сопротивлением 4.5 Ω · cm, на которых предварительно выращивались 6 переходных буферных слоев Si_{1-x}Ge_x толщиной по 0.2 μ m с увеличением доли германия (параметра "x") на 7.5% в каждом слое. Затем формировался слой Si_{0.5}Ge_{0.5} (толщина 1.3 μ m) *p*-типа проводимости с шириной запрещенной зоны 0.91 eV [9].

ИЛО проводилась в экспериментальных условиях [6,10] при длительности импульса излучения рубинового лазера 80 ns по уровню 0.5 от максимума (FWHM) и неоднородности распределения энергии не выше $\pm 5\%$ по зоне облучения диаметром 4.5 mm. Образцы облучались при плотностях энергии ИЛО W = 1.5, 2.0 и 2.5 J/cm². Структура слоев и состояние облученной поверхности исследовались методами просвечивающей (ПЭМ) и растровой (РЭМ) электронной микроскопии на микроскопах ЭМ-125 и LEO-1455VP соответственно.

Измерения спектров ФП исходного и лазерно-модифицированных SiGe слоев проводились в спектральном интервале 0.6–1.4 µm. Исследованный образец (рис. 1, e), наряду с исходной структурой, содержал три облученных лазером участка (W = 1.5, 2.0 и 2.5 J/cm^2) с нанесенными на них после ИЛО серебряными контактами. Освещение образца проводилось со стороны эпитаксиального слоя. Расположение контактов на поверхности освещаемого SiGe слоя позволяло регистрировать изменение именно его проводимости. Этому способствовала также и меньшая, по сравнению с кремнием, ширина запрещенной зоны SiGe, ограничивающая проникновение возбуждающего ФП света в Si подложку. Для возбуждения ФП использовалось выделенное решеточным монохроматором МДР-12У излучение лампы накаливания СИ-100. Регистрация фототока осуществлялась по типичной схеме с подачей внешнего напряжения 10 V на последовательно соединенные образец и сопротивление нагрузки. Изменение падения напряжения на сопротивлении нагрузки после усиления и детектирования подавалось на аналогово-цифровой преобразователь, связанный с персональным компьютером. Полученные спектры нормировались на величину интенсивности излучения, возбуждающего ФП.



Рис. 1. ПЭМ-изображение в поперечной (a, b) и планарной (c) геометриях съемки и РЭМ-снимок (d) слоев Ge_{0.5}Si_{0.5}, облученных при плотностях энергии W = 1.5 (a, стрелкой указана глубина проплавления) и 2.5 J/cm² (b-d), e — фотография образца с контактами для измерений ФП (числами обозначена величина W).



Результаты электронно-микроскопических исследований (рис. 1, a-d) свидетельствуют о переходе части слоя SiGe вследствие лазерно-индуцированных фазовых превращений в новое структурное состояние, радикально отличающееся от исходного. Трансформация состояния облученных участков фиксируется и визуально в связи с изменением не только их структуры, но и оптических характеристик. Области ИЛО достаточно четко выделяются на фотографии образца (рис. 1, e), размер которого 1 сm².

Данные ПЭМ (рис. 1, *a*, *b*) в поперечном сечении (cross-section) зон лазерного воздействия указывают на образование развитой (рис. 1, *a*, $W = 1.5 \text{ J/cm}^2$) и более однородной (рис. 1, *b*, $W = 2.5 \text{ J/cm}^2$) ячеистой структуры (ЯС). Формирование ЯС в инициируемых ИЛО фазовых превращениях связано [8] с сегрегационным вытеснением германия из ячеек, зарождающихся и далее растущих к поверхности на стадии отвердевания бинарного расплава от монокристаллической (не переплавленной) части слоя SiGe. На микрофотографии (рис. 1, *b*) четко видны вертикальные границы между ячейками, обогащенные германием. Из изображения этой ЯС в планарной геометрии ПЭМ (рис. 1, *c*) следует, что средний латеральный размер ячеек составляет около 200 nm.

На изображении (рис. 1, d) изучаемой структуры видны субмикронные поверхностные кластеры с преимущественным содержанием германия, что установлено [8] рентгеноспектральным анализом их состава в ходе проведения РЭМ, т.е. сегрегационное вытеснение германия в процессе формирования ЯС происходит не только к границам ячеек, но и в направлении их роста к поверхности. Скорость роста составляет примерно 0.5 m/s. Она определена на основе данных ПЭМ (рис. 1, b) о толщине модифицированной части слоя SiGe (т.е. глубине проплавления около 1 μ m) и проведенных по методике [6,9] измерений длительности фазовых превращений, которая составила ~ 2 μ s.

Следует отметить, что эффект сегрегации германия в условиях наносекундного лазерного облучения слоев Si_{1-x}Ge_x известен и исследовался, в частности, в работе [2] ($x \le 0.1$) с применением XeCl эксимерного лазера ($\lambda = 308$ nm, 30 ns). В наших экспериментальных условиях ($\lambda = 694$ nm, 80 ns) ранее исследовались [6] особенности лазерной модификации Si-Ge сверхрешеток толщиной 0.6 μ m на подложках Si(100) и наблюдалось формирование вследствие сегрегации Ge подобных (рис. 1, d) ячеистых структур, однако с меньшим (~ 100 nm) средним размером ячеек примерно квадратной формы.



Рис. 2. Спектры ФП исходных (*a*) и лазерно-модифицированных слоев Ge_{0.5}Si_{0.5}/Si; W = 1.5 (*b*), 2 (*c*) и 2.5 J/cm (*d*).

Образование вышеописанных ячеистых структур приводит к существенному изменению электрофизических и фотоэлектрических характеристик эпитаксиальных слоев Si_{0.5}Ge_{0.5}. Контрольные измерения слоевого сопротивления образцов ρ четырехзондовым методом на установке ИУС-3 показали, что исходная величина $\rho = 9.2 \text{ k}\Omega/\Box$ в результате ИЛО слоя уменьшается до 5.0 ($W = 1.5 \text{ J/cm}^2$) и 2.4 k Ω/\Box (2.5 J/cm²). При подсветке излучением HeNe лазера ($\lambda = 633 \text{ nm}$) тестируемой поверхности образцов, т. е. при инициировании ФП, слоевое сопротивление исходного SiGe слоя понижалось на 23%, а лазерномодифицированных слоев — на 13 (1.5 J/cm²) и 5% (2.5). Приведенные данные свидетельствуют о том, что модифицированные ИЛО слои обладают более высокой электропроводностью и меньшей фоточувствительностью в сравнении с исходными параметрами Ge_{0.5}Si_{0.5}/Si.

Исходный эпитаксиальный слой Si_{0.5}Ge_{0.5}/Si характеризуется длинноволновой границей внутреннего фотоэффекта около $\lambda = 1.4 \,\mu m$ и максимумом ФП в окрестности $\lambda = 0.84 \,\mu m$ (рис. 2, *a*). Следствием ИЛО является сдвиг спектра ФП в длинноволновую область в среднем на $\Delta \lambda = 0.05 \,\mu m$ (рис. 2, *b*-*d*). Спектры ФП образцов, модифицирован-

ных в интервале плотностей энергии ИЛО от 1.5 до 2.5 J/cm², различаются незначительно. Это свидетельствует о том, что определяющее влияние на их эволюцию оказывает переход части слоя в качественно новое состояние (образование ЯС), а не изменение количественных характеристик ЯС в этом интервале варьирования величины W.

Сдвиг спектров в длинноволновую область объясняется обогащением германием части объема слоя SiGe вследствие произошедших в нем фазовых превращений. Германий обладает меньшей шириной запрещенной зоны и, соответственно, характеризуется большей чувствительностью к длинноволновому излучению. Значительно меньшее слоевое сопротивление модифицированных слоев SiGe (см. выше) в сравнении с исходным также связано с наличием собственно германия, вытесненного в окрестности ячеек и границы ЯС.

Пониженная фоточувствительность модифицированных слоев ассоциируется со сложностью строения ЯС и высоким содержанием точечных дефектов (дефектов закалки) в кристаллической решетке, что интенсифицирует рекомбинацию генерируемых светом неравновесных носителей заряда (электронов и дырок), обусловливающих возникновение фотопроводимости. Области ЯС с избыточным содержанием германия и, соответственно, с пониженной шириной запрещенной зоны являются стоками электронов и дырок, что способствует ускорению рекомбинационных процессов.

Основным результатом проведенного исследования является получение и интерпретация совокупных данных о структуре и фотоэлектрических свойствах лазерно-модифицированных эпитаксиальных слоев твердого раствора SiGe, что важно при оценке возможностей ИЛО в технологии приборных SiGe-структур.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ по проекту Ф13К-117.

П.И. Гайдук выражает благодарность Международному стипендиальному фонду Марии Кюри (грант № 911932 на выполнение проекта PIIFR-Ga-2011-911932) за поддержку исследования.

Список литературы

- [1] *Poate J.M., Foti G., Jacobson D.C.* (Eds). Surface Modification and Alloying by Laser, Ion, and Electron Beam. Springer, 1983. 414 p.
- [2] Brunco D.P., Thompson M.O., Hoglund D.E., Aziz M.J., Gossmann H.-J. // J. Appl. Phys. 1995. V. 78 (3). P. 1575–1582.

[3] Krishnan S., Chaundhry M.I., Babu S.V. // J. Mater. Res. 1995. V. 10. N 8. P. 1884–1888.

15

- [4] Larciprete R. Willmor P. Martelli S. et al. // Appl. Surf. Sci. 1996. V. 106.
 P. 179–185.
- [5] Frangis N, Van Landuyt J, Larciprete R. et al. // Appl. Phys. Lett. 1998. V. 72. N 22. P. 2877–2879.
- [6] Sobolev N.A., Ivlev G.D., Gatskevich E.I. et al. // Mater. Sci. Eng. C. 2003. V. 23. P. 19–22.
- [7] Weizman M., Nickel N.H., Sieber I., Yan B. // J. Appl. Phys. 2008. V. 103.
 P. 093 536-1–093 536-10.
- [8] Gaiduk P.I., Prakopyev S.L. // Springer Series in Material Science. 2013. V. 192. P. 79–105.
- [9] Панков Ж. Оптические процессы в полупроводниках / Под ред. Ж.И. Алфёрова и В.С. Вавилова. М., 1973. 456 с.
- [10] Ивлев Г.Д., Гацкевич Е.И. // ЖТФ. 2012. Т. 82. В. 6. С. 69-72.